

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-067

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，提质增效促发展

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，2025 年前三季度，公司三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升，与此同时公司营业收入及净利润实现了较好的增长。2025 年前三季度，公司实现营业收入 4.82 亿元，较上年同期增长 87.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，较上年同期增长 178.18%。

2026 年，公司将继续聚焦主营业务，在集成电路测试分选领域深耕，不断加强自主技术创新能力，向更广的测试温度范围、更多并测工位、更多类型的产品测试等方面进一步创新和发展来满足更多类型的测试分选需求，全面提升公司的核心竞争力与盈利能力，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面：

(一) 持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势

公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2026年，公司将持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进并计划于2026年投入使用。2026年，“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”投入使用，将进一步增加公司研发及智能制造等方面的综合竞争力。

(二) 持续拓展全球市场版图

公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025年，公司“马来西亚生产运营中心”启用，助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。2026年，公司将继续积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设。

(三) 积极进行产业及技术战略布局

公司在继续加大技术开发和自主创新力度的同时，也积极通过对外投资方式布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了苏州猎奇智能设备股份有限公司、瑞玛思特（深圳）科技有限公司等5家公司。2026年，公司将深化研发能力建设，积极布局重点关注的技术方向。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会、上海证券交易所下发的法律法规、规范性文件等要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。

2025年12月，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，取消了监事会并由董

事会审计委员会行使监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理制度。

自 2023 年上市以来，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识。2026 年，公司将继续积极组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区证监局组织的各类培训，持续深化证券市场法律法规研习，切实强化学规履职能力与风险防控意识，推动公司规范运作。

2026 年，公司将继续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

三、提高信息披露水平，加强投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。

2026 年，公司将继续遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，提高信息披露水平，公平地对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

公司坚持稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对公司分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，以制定合理的利润分配方案。

自 2023 年上市以来，公司积极进行现金分红并适时推出股份回购计划。为维护股东利益，增强投资者信心，2024 年，公司回购 242.3970 万股公司股票。

2026 年，公司将继续秉持积极回馈投资者的理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、强化管理层与股东的利益协同约束

公司于 2024 年及 2025 年先后实施了员工持股计划，实现了高级管理人员及骨干人员利益和公司股东利益的绑定，共同推进公司的高质量发展。公司员工持股计划设置了公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核，上述员工持股计划有助于公司进一步搭建并完善长效激励体系，助力吸引与留存核心优秀人才，充分激发员工的主观能动性与创造力；通过将股东利益、公司发展与核心团队个人价值实现深度绑定，推动各方形成长期发展共识与合力，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026 年，公司将在上述员工持股计划对应解锁期届满后，根据公司和员工持股计划参与对象的实际情况审议相关解锁议案。

六、其他说明

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主营业务，完善公司治理，加强投资者关系管理，完善投资者回报机制，致力于提升公司发展水平和投资价值，切实维护全体股东合法权益。

需要特别说明的是，本公告所涉及公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业发展状况、政策法规等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日